

日亜化学工業株式会社辰巳 SLP13 BB FC

稲田龍太郎

フリップチップ

刻印を左

空箱を移す

試料を入れる

開始 QR

社員 QR

1,2QR

作業開始 QR

製品×2QR

記入

ウエハー→マガジンセット→設備間 I/F→VS/つまり→実装ステージ→強度間

MANUAL

AOUT

パラメータ

自動

供給ヘッド

実装ヘッド

①②③④ヘッド カメラ切替

マニュアル操作

ユニット

ON

中心 OS

チップ供給

補正

補正実装

チップアトルスク変更

設定

ファーストチップ先頭

ファーストチップ方向

キラメキ

エラー

リセット

マニュアル

パラメーター

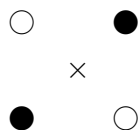
供給ヘッド←クリーニング

実装ヘッド

接続確認

AOUT

マガジンプレート挿入



AUTO/START

マップ1有2有

カット外す

強度レ

QR 開始

① アラメント有 開ける

ウエハ→マガジンセット→設備間 I/F 連動生産→パラ→US ノズル原点→②FC→③カ
メラ/有④接触キャリアバーコード/有→⑤FC データショートカット

XYθ

±5,±5,0.3

パラメータ

作業完了後

レンズマッピング

↓データメンテナンス

↓マッピングデータ (3つ目)

↓ロットナンバーQR

↓3つ目 2DC (R1)

↓ARMS

左右一致 (数字メモ)

↓ARMS データ実数入力

検索

NG 不良更生

↓警告を外す

↓ロット連携

↓テーブル

↓ARMS データ

↓NASCA 連動

流動

QR (ロット)

カレンダーチェック

↓NASCA2

2つ目のアSEMBリ

ロットナンバー☐

完成数量

検査

FC

MOUT

デリート

3つ目

QR (社員)

作業完了 QR

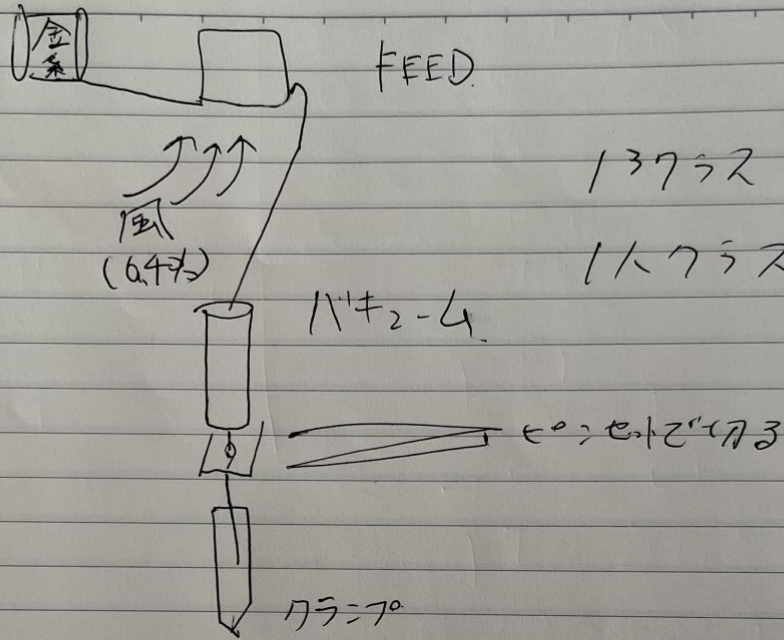
QR (社員)

↓決定

金系

No.

DATE



13752 は

11ノズル

11#2-4

セメント

ノズル=70

半導体の部品